

TUM und Qimonda rücken zusammen

Die TUM und der weltweit tätige Speicherchip-Hersteller Qimonda AG, München, werden künftig in den Bereichen Nachwuchsausbildung, Produktentwicklung und systematischer Wissensaustausch enger kooperieren. Beide Partner unterschrieben dazu im August

»Mit der heutigen Vereinbarung gewinnen wir einen weiteren führenden industriellen Partner im Bereich der Spitzentechnologie«, sagte TUM-Vizepräsident Prof. Arndt Bode. »Die TU München leistet mit ihren Forschungen und der Nachwuchsausbildung wichtige Beiträge ent-

ckeln zu können. Wir wollen gezielt Nachwuchs fördern und Wissensnetzwerke zwischen Industrie und Universität bilden.« Darüber hinaus sehe Qimonda die Zusammenarbeit als wichtigen Beitrag zur Sicherung des Technologiestandorts Deutschland.

Schon bisher bestanden Kontakte und Aktivitäten zwischen Abteilungen von Qimonda und Einrichtungen der TUM. Um gemeinsame Projekte zu bündeln und auf eine neue, zukunftsweisende Grundlage zu stellen, unterzeichneten Kin Wah Loh (l.) und Prof. Arndt Bode die neue Vereinbarung.

Foto:
Faces by Frank



Geplant sind Stipendien für TUM-Studierende und gemeinsame Lehrveranstaltungen; Praktikumsplätze sollen bereitgestellt und Diplom- und Dissertationsthemen vergeben werden. Neben gemeinsamen Tagungen sind auch Besuche und Seminare an Qimonda-Standorten vorgesehen, zum Beispiel dem 300-mm-Werk in Dresden. Ziel ist, mit einem Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen neue Wissensnetzwerke zu schaffen und den Austausch zwischen Universität und Industrie zu intensivieren.

red

2007 ein »Memorandum of Understanding« als ersten Schritt für weitere Maßnahmen.

lang der gesamten Wertschöpfungskette in der Halbleiter-Technologie: von der Physik über die Materialwissenschaften bis hin zur Informatik und Informationstechnologie. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Projekte.« Kin Wah Loh, Vorstandsvorsitzender der Qimonda AG, kommentierte das Rahmenabkommen: »Die Zusammenarbeit mit Universitäten, und hier ganz besonders der TU München, ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir brauchen die enge Anbindung an Universitäten, um Spitzentechnologien gemeinsam schneller weiterentwi-